**前 言**

随着“中国制造2025”、“互联网+”以及“国家大数据战略”的组织实施，我国半导体产业发展取得了一系列成果。西安集成电路产业也取得了突破性进展，产业规模不断扩大，产业结构快速调整，技术水平大幅提升，产业发展日趋成熟。为反映西安集成电路产业发展的全面情况，我们编写了《西安集成电路产业发展研究报告》（2017年版），以下简称《产业报告》。

《产业报告》汇集了2016年和2017年已发布的国内外产业发展主要数据，以及西安集成电路产业发展现状。针对西安集成电路产业的发展状况、产业投融资情况、产业环境等进行重点分析和研究，并包含了国内外产业投融资情况和存在的矛盾、问题等内容。研究范围除了集成电路产业，还包含分立器件和支撑业。

《产业报告》的编写工作不仅得到了各级领导的关心与指导，许多专家和企业也给予了支持和帮助，在此表示衷心的感谢。

不足之处，请批评指正。

**目 录**

[一、产业概况 1](#_Toc515260399)

[（一）国际概况 1](#_Toc515260400)

[1、产品类别方面 2](#_Toc515260401)

[2、市场应用方面 3](#_Toc515260402)

[3、市场分布方面 4](#_Toc515260403)

[4、三业发展情况 5](#_Toc515260404)

[5、技术发展方面 5](#_Toc515260405)

[（二）国内概括 5](#_Toc515260406)

[1、产品类别方面 6](#_Toc515260407)

[2、市场应用方面 7](#_Toc515260408)

[3、进出口方面 8](#_Toc515260409)

[4、产业链发展情况 9](#_Toc515260410)

[5、技术发展方面 15](#_Toc515260411)

[二、西安集成电路产业发展状况 16](#_Toc515260412)

[（一）集成电路产业基本情况 16](#_Toc515260413)

[1、产业规模 16](#_Toc515260414)

[2、产业链情况 17](#_Toc515260415)

[3、三业结构 18](#_Toc515260416)

[（二）产业链发展情况 18](#_Toc515260417)

[1、集成电路设计业 18](#_Toc515260418)

[2、晶圆制造业 21](#_Toc515260419)

[3、封装测试业 22](#_Toc515260420)

[4、分立器件业 25](#_Toc515260421)

[5、支撑业 25](#_Toc515260422)

[（三）存在问题 27](#_Toc515260423)

[三、集成电路产业发展环境 27](#_Toc515260424)

[（一）集成电路产业主要政策 27](#_Toc515260425)

[1、国家政策 27](#_Toc515260426)

[2、本地政策 30](#_Toc515260427)

[（二）专业服务平台 32](#_Toc515260428)

[（三）近年重大投资 33](#_Toc515260429)

[1、全国重大投资 33](#_Toc515260430)

[2、西安重大投资 34](#_Toc515260431)

[四、集成电路产业发展存在的问题 36](#_Toc515260432)

[（一）产业结构与需求之间失配 36](#_Toc515260433)

[1、核心芯片主要依赖进口 36](#_Toc515260434)

[2、资源错配造成“两头在外” 37](#_Toc515260435)

[3、制造能力与设计能力失配 37](#_Toc515260436)

[4、集成电路产品也面临挑战 38](#_Toc515260437)

[（二）生产线建设缺少统筹 38](#_Toc515260438)

[（三）技术和投资尚未实现平衡驱动 39](#_Toc515260439)

[（四）人才团队严重短缺 39](#_Toc515260440)

[五、西安集成电路展望 40](#_Toc515260441)

[附 录 42](#_Toc515260442)

[附录一：2017年度西安集成电路产业大事记 42](#_Toc515260443)

[附录二：西安集成电路设计业代表企业名单 44](#_Toc515260444)

[附录三：西安晶圆制造业代表企业名录 46](#_Toc515260445)

[附录四：西安封装测试业代表企业名录 46](#_Toc515260446)

[附录五：西安支撑业代表企业名录 47](#_Toc515260447)

[附件六：2016年全球十大设计企业名单 48](#_Toc515260448)

[附件七：2016年全球十大集成电路代工企业 48](#_Toc515260449)

[附件八：2016年全球前10集成电路封装企业 49](#_Toc515260450)

[附表九：2016年全球集成电路产业十大IDM公司 50](#_Toc515260451)

[附件十：2016年全球前20大半导体厂商 51](#_Toc515260452)

[附件十一：“十三五”期间新建制造项目汇总 52](#_Toc515260453)

[附件十二：主要城市集成电路产业专项政策汇总 53](#_Toc515260454)